

证券代码：300136

证券简称：信维通信

深圳市信维通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-08

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	2021年09月13日 CLSA; Dantai Capital Limit; Eastspring Investments; Franklin Resources; Hao Great China Focu; Keywise Capital Management; Millennium Par Group; Polar Capital llp; Somerset Capital Management 等; 2021年09月17日 中金公司、重阳投资、东方马拉松、精至资产等; 以上排名不分先后。
时间	2021年09月13日、17日
地点	2021年09月13日 电话会议 2021年09月17日 深圳市南山区特发信息港A栋北3楼 现场调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：杨明辉 证券事务代表：伍柯瑾
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司各业务经营情况的介绍 当前，公司处于业务转型优化阶段，成熟业务（天线、无线充电、EMI/EMC）保持稳步增长，新业务（LCP、BTB、被动元件、汽车互联产品、UWB等）呈现快速增长。 在无线充电领域，公司无线充电业务从手机接收端逐步拓展至手机发射端、耳机、手表等各类终端应用。公司保持了无线充电材料的领先优势，纳米晶材料、非晶材料、3D铁氧体材料均得到客户

的认可。公司一直推进大客户策略，已成为北美客户、安卓系主流厂商的核心合作伙伴，合作领域不断拓展。在北美客户方面，今年公司巩固了手机无线充电接收端的核心地位与供应份额，并逐步切入了无线耳机、手表等终端应用，后续将会进一步切入手机发射端、平板电脑等领域。在安卓系客户方面，公司在几个主流厂商继续保持着领先供应地位，除了手机无线充电接收端之外，也切入了无线耳机、手表等终端应用，正在放量过程中。整体来看，公司无线充电正快速拓展各类终端应用，收入规模保持着良好的增长。

在 LCP 领域，公司将 LCP 作为重点拓展的新业务，经过几年的技术沉淀，已经形成了“LCP 材料-->LCP 天线-->LCP 模组”一站式解决方案能力，能够提供更多规格、更高精度、更容易调节性能、更高品质、更低成本的 LCP 产品。在安卓系客户方面，公司的 LCP 产品早已量产，已拿到订单的客户涵盖了国内、外的手机厂商，同时公司也与主流手机厂商展开 LCP 新项目的开发，预计未来搭载 LCP 的安卓系终端应用越来越多。在北美客户方面，公司也取得突破性进展，公司按照先切入手表再攻克手机等其它终端应用的策略，且目前手机 LCP 也开始与北美客户展开测试交流，争取早日切入北美客户的手机等应用，这将给公司带来较大的业务空间。整体来讲，公司 LCP 正与全球各大客户展开交流与合作，随着 LCP 业务的不断推进，LCP 业务也将不断壮大。

在 BTB 类连接器业务方面，公司结合自身在电磁屏蔽、电磁泄漏处理等能力的优势，在 BTB 领域建立了从产品设计到产品制造的一站式解决方案能力，产品已经得到了各大客户的认可。随着 5G 时代的推进，智能手机、智能手表等各类电子终端对 BTB 的需求越来越大，全球市场规模大概在 120 亿元附近，目前主要由日本厂商主导，未来国产替代的机会比较大。目前，公司正在加大 BTB 型号的丰富，扩大产能，开拓更多的客户，努力实现该领域的国产替代，公司希望未来能做到 20-30% 的市占率。BTB 连接器是一个具有较高毛利率的业务，参照国外同行，均有不错的毛利率表现。目前，公

司 BTB 业务规模正在扩大过程中，毛利率水平也在逐步提升，公司努力争取更好的盈利表现。

在被动元件方面，2021 年是公司在被动元件领域的战略发展元年。公司已做相关前期筹备工作，包括材料、配方、生产工艺等方面的研究与投入，并在韩国、日本建立了研究中心，引入国内外顶尖人才，加强被动元件高端化的研究。目前，公司已通过收购聚永昶快速搭建了电阻的研究和生产平台；今年 7 月份，公司全资子公司益阳信维就对外投资合作发展片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目签署了《战略合作协议》，共同打造高端 MLCC 产品基地，构建科技创新生态。公司在被动元件领域的整体战略布局，正在根据自身的规划稳步推进，在持续产能投入建设的同时，加紧对销售渠道以及客户的开拓。随着相关业务的发展，预计公司将与更多优质客户建立长期稳定合作，并进一步优化产品结构，在产能快速扩充的同时，实现产能的陆续释放。

汽车互联业务方面，公司已开拓大众、东风本田、奔驰等国内、外多家汽车客户，可为客户提供车载无线充电、车载天线、UWB 模组等产品及整合配套服务，同时也正在与十余家主流厂商进行深入接触。公司与现有客户的稳定合作，将对更多品牌客户形成示范效应，有利于扩大品牌推广成效，切入更多汽车行业客户，形成相关业务的新增长点。今年 5 月，公司也正式加入了汽车数字连接协会（Car Connectivity Consortium），加快对汽车数字钥匙研究的推进。总体而言，公司会根据客户的需求，在已有产业基础上发挥主营业务优势，积极拓展汽车互联相关业务。

整体而言，公司当下处于业务转型优化阶段，成熟业务（天线、无线充电、EMI/EMC）保持稳步增长，新业务（LCP、BTB、被动元件、汽车互联产品、UWB 等）呈现快速增长，各项业务保持着稳步向上的势头。公司在积极开拓新业务的同时，毛利率阶段性承压，随着新业务逐步发展以及下半年消费电子旺季到来，公司的盈利能力预计逐步提升。此外，公司还将继续积极应对外部环境变化及产业阶

段性挑战所带来的压力，围绕经营规划，努力降本增效，实现经营目标。

第二部分：问答环节

问题：公司无线充电业务进展？如何应对同行的竞争？

过去，公司无线充电业务收入大部分来自于手机接收端；当前，公司无线充电业务从手机接收端逐步拓展至手机发射端、耳机、手表、平板等各类终端应用，非手机接收端逐步成为公司无线充电业务增长动力。目前，公司无线充电在各大客户的供应商地位稳固，在巩固现在手机接收端项目供应份额的同时，不断拓展了发射端、无线耳机、手表等终端应用，这些新拓展终端应用的无线充电正在放量过程中。整体来看，公司无线充电业务规模保持着良好的增长，且毛利率也处于逐步提升过程中。

任何一项业务都有同行的竞争，关键在于自身业务竞争优势。公司的竞争力体现在“材料→零件→模组”一体化能力上，特别是上游材料的优势，这一点也体现在无线充电业务上。公司保持了无线充电材料的领先优势，纳米晶材料、非晶材料、3D 铁氧体材料均得到客户的认可。在新终端应用的推广过程中，公司凭借着材料突出的性能与成本，先为客户提供无线充电材料解决方案。随着公司无线充电在各类终端应用的拓展，公司无线充电规模不断扩大，整体市场占有率也不断提升。

问题：公司电阻、MLCC 业务的进展与规划？

被动元件是公司重点发展的战略性业务，目前电阻已投产并加紧扩产，MLCC 已做好规划，2021 年也是公司被动元件业务发展的元年。从市场需求来看，公司发展的高端电容电阻等业务主要被海外厂商垄断，存在国产替代的需求。

面对巨大的国产替代的需求，公司从人才、技术、设备工艺等方面做好了充分的准备。公司已做相关前期筹备工作，包括材料、

配方、生产工艺等方面的研究与投入，并在韩国、日本建立了研究中心，引入国内外顶尖人才，加强被动元件高端化的研究，公司根据自身产品需求对生产设备进行开发与定制。

在电阻业务方面，公司收购聚永昶快速搭建了电阻的研究和生产平台，并加快自身电阻产品的产能扩张。今年上半年，公司电阻业务推进顺利，业务正处于放量过程中。

在 MLCC 方面，公司已经做好了业务规划，全资子公司益阳信维就对外投资合作发展片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目签署了《战略合作协议》，共同打造高端 MLCC 产品基地。

公司聚焦高端电阻和 MLCC，随着相关业务的发展，预计公司将与更多优质客户建立长期稳定合作，快速扩充产能，实现被动元件业务的做大做强。

问题：公司在 VR 领域做了哪些业务？未来是否有可能将无线充电技术运用在 VR 领域？

公司可以为 AR/VR 终端设备提供天线、EMI/EMC 精密零件、无线充电、BTB 连接器等产品与服务。现在已为 F 客户旗下的 VR 终端提供天线、EMI/EMC 精密零件等产品，同时也在为北美客户储备新项目。公司重视 AR/VR 领域的发展，加大项目和客户的拓展，预计未来公司 AR/VR 相关业务会越来越多。目前，AR/VR 终端设备形态丰富，无线充电也将成为 AR/VR 设备的重要充电方式。

问题：公司 UWB 业务情况？

公司是较早切入该领域的厂商，是 FiRa 联盟（UWB 领域最专业的权威的组织机构）的重要成员。公司与 NXP 达成战略合作，结合 NXP 与公司的渠道，共同推进 UWB 在 IoT 市场的应用，公司已经建立了明显的卡位优势。目前，NXP 基于全新的 Trimension 芯片系列，推出多种 UWB 产品组合，旨在为汽车、智能手机和物联网设备提供量身定制的传感解决方案。在此基础上，公司与 NXP 合作开发了专

	<p>为物联网应用优化的 UWB 模块，并开发了相应的套件，可提升产品的设计效率和加快产品上市速度，并降低开发成本。</p> <p>目前，公司正在多个领域和国内外一线厂商联合开发相关应用，也有很多厂商主动上门寻找与公司在 UWB 领域的合作。随着未来终端市场对 UWB 技术需求的拓展，相关业务的增长将对公司业绩形成新的支撑点。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2021-09-18